



电子化工新材料产业联盟

简 报

2020 年 第 12 期

电子化工新材料产业联盟秘书处编印

地址：北京市朝阳区胜古中路 2 号院金基业大厦 716 室电话：010-64476901/64498802

邮箱：cem@cemia.org.cn

传真：010-64455623

联盟网站：www.ecmr.org.cn

微信公众号：电子化工新材料产业联盟

目 录

【政策文件】

两部门关于开展 2020 年度重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知

【行业要闻】

总投资 14 亿美元，无锡 SK 海力士 M8 正式投产

士兰微 12 吋芯片生产线正式投产

总投资 440 亿元，维信诺（合肥）六代全柔 AMOLED 产线成功点亮

河南首个面板项目华锐光电在郑州航空港区正式点亮

瑞华泰科创板 IPO 过会

年产 3130 吨硅基电子气体项目举行开工仪式

新宙邦(300037.SZ)拟在江苏南通投建 2.5 万吨新型电子化学品项目

【统计数据】

5900 亿！中国集成电路产业最新数据出炉

【产业分析】

台媒：晶圆代工先进制程需求旺，预计今年产能持续吃紧

【政策文件】

两部门关于开展 2020 年度重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知

工信厅联原函〔2020〕297 号

各省、自治区、直辖市及计划单列市工业和信息化主管部门，各银保监局，有关中央企业：

按照《关于开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知》（工信部联原〔2017〕222 号）等要求，为做好 2020 年度重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作，现就有关事项通知如下：

一、生产《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》内新材料产品，且于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间投保重点新材料首批次应用综合保险的企业，符合首批次保险补偿工作相关要求，可提出保费补贴申请。承保保险公司符合《关于开展重点新材料首批次应用保险试点工作的指导意见》（保监发〔2017〕60 号）相关要求，且完成重点新材料首批次应用保险产品备案。

二、申请保费补贴的产品应由新材料用户单位直接购买使用，用户单位为关联企业及贸易商的不得提出保费补贴申请，原则上单个品种的销售合同金额不低于 500 万元。

三、已获得保险补贴资金的项目，原则上不得提出续保保费补贴申请。用于享受过保险补偿政策的首台套装备的材料不在本政策支持范围。

四、符合条件的企业可向所在地省级工业和信息化主管部门及所属中央企业提交保费补贴申请材料（具体要求见附件 1）。省级工业和信息化主管部门或中央企业会同地方银保监局对申请材料进行初审后，请于 2021 年 1 月 25 日前将初审意见、本地区申请材料汇总表（格式见附件 2）纸质版一式三份和电子版报送工业和信息化部（原材料工业司）。

五、申报形式采用线下申报和线上试点相结合，在湖南省和中国铝业集团有限公司开展线上申报评审试点工作。参与线上试点的单位需同时按要求提交相关纸质和电子版材料。

联系方式：

工业和信息化部（原材料工业司） 李瑾 010-68205768

银保监会（财产保险监管部） 付小娟 010-66286858

邮寄地址：北京市西城区西长安街 13 号工业和信息化部（原材料工业司）

工业和信息化部办公厅 银保监会办公厅

2020 年 12 月 22 日

【行业要闻】

总投资 14 亿美元，无锡 SK 海力士 M8 正式投产

无锡高新区集成电路产业又传来喜讯，总投资 14 亿美元的 SK 海力士 M8 项目正式投产。

M8 项目是指海辰半导体（无锡）有限公司和 SK 海力士系统集成电路（无锡）有限公司共同投资建设的 8 英寸非存储晶圆项目。项目投产后将月产 11.5 万枚 8 英寸晶圆片，远高于国内外其他企业月产 5 万枚的平均水平。

目前全球 8 英寸晶圆需求爆发，M8 项目拥有稀缺的高性能 8 英寸设备及一流的技术，可以生产 57 纳米-500 纳米不同产品，有助于缓解目前国内 8 英寸晶圆产能不足、供不应求的局面，推动国内 IC 设计业稳定有序发展。

士兰微 12 吋芯片生产线正式投产

2020 年 12 月 21 日,厦门海沧,士兰微电子 12 吋芯片生产线正式投产!

士兰微电子 12 吋芯片生产线项目由厦门士兰集科微电子有限公司负责实施运营，规划项目总投资 170 亿元，规划建设两条以功率半导体芯片、MEMS 传感器芯片为主要产品的 12 吋特色工艺功率半导体芯片生产线。

第一条 12 吋产线，总投资 70 亿元，工艺线宽 90 纳米，计划月产 8 万片。本次投产的产线就是其中的一期项目，总投资 50 亿元，规划月产能 4 万片；项目二期将继续投资 20 亿元，规划新增月产能 4 万片。

第二条 12 吋生产线预计总投资 100 亿元，将建设工艺线宽 65 纳米至 90 纳米的 12 吋特色工艺芯片生产线。

总投资 440 亿元，维信诺（合肥）六代全柔 AMOLED 产线成功点亮

12 月 7 日，维信诺子公司合肥维信诺投建的合肥第 6 代柔性 AMOLED 生产

线成功点亮。

维信诺（合肥）G6 全柔 AMOLED 生产线投资总额达 440 亿元，于 2018 年 12 月 27 日启动建设，基板尺寸为 1500mm*1850mm，设计产能为 30K/月。

2019 年 10 月 16 日，维信诺（合肥）G6 全柔 AMOLED 生产线主体结构封顶。

该生产线定位为全柔高定。面对可折叠屏的市场大趋势，可实现柔性折叠产品的更高性能，是维信诺在全面屏、高端折叠、低功耗等方向做出的前瞻布局，且可为客户提供提供高端定制化服务。

河南首个面板项目华锐光电在郑州航空港区正式点亮

2020 年 12 月 31 日，河南省首家液晶显示面板生产制造企业——华锐光电五代薄膜晶体管液晶显示器件项目正式点亮，郑州航空港经济综合实验区管委会副主任魏学彬和相关单位主要负责同志参加。此次点亮标志着河南正式步入液晶显示屏自研自产时代。

项目自 2019 年 3 月开始主体结构施工，近万根桩基同时作业，当年 8 月即实现主厂房封顶，经过 400 多天夜以继日的安全施工，并克服疫情带来的不利影响，主体厂房、综合动力厂房及其他配套建筑已全部竣工。2020 年 4 月开始主厂房清洁，5 月 15 日首台 STK 设备入场，8 月 18 日首台工艺设备搬入，12 月 31 日顺利点亮。

华锐光电作为河南省首家液晶显示面板生产制造企业，位于郑州航空港经济综合实验区南部高端制造业集聚区，一期建设面积 34.17 万平方米，总投资额约 68 亿元。集电子产品、通讯产品、数码产品技术研发、生产和销售于一体，其引进的韩国 TFT-LCD 液晶面板生产线，以 a-Si 技术为核心，全力打造智能化系统，填补了河南省在新型显示产业领域的空白。

随着液晶面板发展的多元化及 5G 时代的到来，作为河南面板龙头企业，华锐光电未来将拓展多元化开发渠道，其产品定位于尺寸 1000mm*1200mm 的玻璃基板，涵盖 1.44-42 英寸多尺寸，可满足车载显示、智能家居、可穿戴显示、智慧医疗、精密工业仪器及部分智能手机等多种市场需求。

瑞华泰科创板 IPO 过会

12月8日晚消息,深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“瑞华泰”或“公司”)首发事项获审议通过,成为今年科创板过会的第196家企业。本次IPO,瑞华泰拟募资4亿元,全部用于嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目建设。

瑞华泰是国内PI薄膜产业化的先行者。公司自主掌握配方、工艺及装备等完整的高性能PI薄膜制备核心技术体系,主要产品系列包括热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜等,广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领域。经过多年研发创新,公司多个系列产品性能达到行业先进水平,是高端市场的有力竞争者。

年产3130吨硅基电子气体项目举行开工仪式

12月30日,洛阳中硅高科电子信息材料项目正式开工。

项目总投资约15.6亿元,计划于2021年1月开始实施,2022年10月建成。

项目产品主要包括两部分:高纯多晶硅产品,高纯四氯化硅与硅基电子气体产品。建设一条300t/a高纯多晶硅生产线,其中区熔级多晶硅占55%,电子级多晶硅占45%;建设一条高纯四氯化硅与硅基电子气体生产线,高纯四氯化硅产品用于下游光纤预制棒生产,包括6000t/aVAD四氯化硅和纯度更高的120t/aPCVD级四氯化硅;硅基电子气体产品用于下游集成电路制造的外延、化学气相沉积、离子注入、掺杂、刻蚀、清洗、掩蔽膜生成等工艺过程,包括80t/a电子级四氯化硅、2000t/a电子级三氯氢硅、500t/a电子级二氯二氢硅、50t/a原料级六氯乙硅烷、50t/a电子级六氯乙硅烷和500t/a电子级正硅酸乙酯。项目高纯四氯化硅及硅基电子气体均采用中硅高科现有的技术,以精馏提纯工艺为主,辅以络合、吸附等技术。

新宙邦(300037.SZ)拟在江苏南通投建2.5万吨新型电子化学品项目

新宙邦(300037.SZ)公告,公司拟以全资子公司南通新宙邦电子材料有限公司(简称“南通新宙邦”)为项目实施主体,在江苏省南通市经济技术开发区化工园区投资建设2.5万吨新型电子化学品项目,项目投资金额预计为人民币7000万元,建设周期1年,预计2022年逐步投产。

公告显示,项目建设内容为:年产1.5万吨超纯氨水、1万吨BOE。

预测项目建成投产后,年均销售收入1.46亿元,年均净利润2104.09万元。

【统计数据】

5900 亿！中国集成电路产业最新数据出炉

2020 年前三季度，中国集成电路产业销售额 5905 亿元，同比增长 16.9%。其中集成电路设计业销售额 2634.2 亿元，同比增长 24.1%；晶圆制造业销售额 1560.6 亿元，同比增长 18.2%；封装测试业销售额 1711 亿元，同比增长 6.2%。

三业销售比重来看，设计业占比 44.6%，大幅提升；晶圆制造业占比 26.4%；封装测试业占比 29%，继续下降。

【产业分析】

台媒：晶圆代工先进制程需求旺，预计今年产能持续吃紧

据台媒经济日报报道，5G 和高性能计算应用带动晶圆代工先进制程需求，预计今年全球晶圆代工产值和 12 英寸晶圆厂投资规模再创新高。其中台积电 5 纳米制程比重可大幅提升，7 纳米产能满载到第 2 季，联电 8 英寸晶圆产能持续吃紧，环球晶晶圆产能满载持续到上半年。

展望今年半导体晶圆代工产业景气，国际半导体产业协会（SEMI）预测，今年云端服务、服务器、笔记本电脑、游戏及医疗科技需求成长，5G、物联网、汽车及人工智能（AI）快速发展，带动晶圆代工产业景气和 12 英寸晶圆厂投资，预估今年全球 12 英寸晶圆厂投资规模可较去年成长 4%，再创历史新高。对此，市场研究机构 TrendForce 也预估今年晶圆代工产值可望再创新高，年成长近 6%。

展望今年上半年 5 纳米和 7 纳米先进制程市况，业内人士指出，5 纳米利用率仍相对乐观，台积电并没有砍单或产能利用率下滑状况，预估今年上半年 5 纳米制程需求仍看佳；此外全球 7 纳米以下量产能力只有台积电和韩国三星，台积电良率高于竞争对手，今年上半年台积电在 5 纳米和 7 纳米先进制程产能仍可占优势。

台积电 5 纳米制程去年下半年大量生产，其中晶圆 18 厂主要生产 5 纳米制程产品，去年全年营收比重估约 8%，预估今年 5 纳米制程业绩占比有望大幅提升。

外资人士指出，今年第 1 季台积电 5 纳米稼动率仍维持高档，主要是苹果（Apple）的高端应用处理器（AP）囊括绝大部分的产能。TrendForce 表示，尽管台积电 5 纳米制程因华为旗下海思遭限制投片，产能利用率仍可维持在 9 成高档。

另外台积电 7 纳米制程受惠超威（AMD）、联发科、英伟达及高通的强劲需求，产能近乎满载，预计将持续到今年第 2 季。此外台积电还有机会接获英特尔的委外代工订单。

另一晶圆代工厂联电在面板驱动 IC 与电源管理芯片需求强劲带动下，8 英寸晶圆代工产能供不应求，涨价趋势确立。联电去年 12 月中旬通过新台币 286.56 亿元资本预算执行案，将扩充南科厂 12 英寸产能，以 28 纳米制程占大宗，因应客户强劲需求。

而中芯国际此前被美国列入国防黑名单，业内人士指出中芯先进制程仍受美国管制，联电产能持续供不应求。

除此之外，力积电 12 英寸和 8 英寸晶圆代工产能利用率已达 100%，持续受惠利基型 DRAM、电源管理 IC、面板驱动 IC、CMOS 影像传感器等订单强劲，今年上半年产能已被客户预订一空。

先进晶圆制程也带动 12 英寸硅晶圆需求，展望今年硅晶圆产业供需，投顾人士预期今年硅晶圆供需结构有望好转，硅晶圆需求 70% 主要来自 12 英寸硅晶圆，内存又占 12 英寸硅晶圆应用比重超过 5 成，12 英寸硅晶圆市场需求强劲。

环球晶指出，6 英寸、8 英寸与 12 英寸硅晶圆产能满载，到今年上半年可望维持满载，考虑产能满载及汇率因素，环球晶已调涨 12 英寸硅晶圆现货价，其余产品现货价也将逐步调涨。综合长期合约比重滑落影响，环球晶预期今年产品平均售价可能较去年持平。

展望今年下半年到明年 2022 年，因应众多高性能计算（HPC）客户在 2022 年强劲订单需求，TrendForce 指出台积电及三星已有积极扩张 5 纳米产能计划。台积电表示，5 纳米制程去年已量产，但不对外披露个别厂区量产时程和月产能进度。

TrendForce 预期，今年下半年即使 COVID-19 疫情缓解使得电视、笔记本电脑等宅经济需求产品发生零部件库存修正的可能性仍存在，不过通信世代交替，

5G、Wi-Fi 6 等基础建设布局持续发酵，加上 5G 智能手机渗透率提升，将持续推动晶圆代工厂产能利用率维持 90% 高档，另一方面若中芯国际禁令未解，原先在中芯生产的半导体零组件，势必寻求其他晶圆厂协助，全球晶圆代工市况将比现阶段更加紧缺。

电子化工新材料产业联盟